重2019N001 存储芯片超薄高密度封装基板关键技术研发

一、领域：电子信息技术—微电子技术

二、主要研发内容：

（一）精细节距打线手指技术开发；

（二）超薄板技术开发。

三、项目考核指标（项目执行期内）

（一）经济指标：实现销售收入≥3000万。

（二）学术指标：申请专利≥8件，其中发明专利≥5件。

（三）技术指标：

1. 手指节距≤60μm；

2. 手指宽度≤35μm；

3. 手指间距≤15μm；

4. 封装基板厚度≤80μm；

5. 芯板介质厚度≤30μm；

四、项目实施期限：3年。

五、资助资金：不超过1000万元。